

# 会社案内



株式会社 熊本マランツ

# 会社概要

社名

株式会社 熊本マランツ

所在地

熊本県宇土市花園町西原2024

設立

1972年(昭和47年) 10月5日

資本金

5,000万円

役員

代表取締役	深津	悦夫
取締役	内川	智
取締役	西澤	英樹(マランツエレクトロニクス(株)代表取締役会長)
取締役	元木	満(マランツエレクトロニクス(株)代表取締役社長)
監査役	齋藤	仁宏(マランツエレクトロニクス(株)管理部長)

従業員

78名(2026/1/16現在)

土地建物

土地 10,720m<sup>2</sup> 建物 5,080m<sup>2</sup>

事業内容

電気・電子機器組立(SMT実装～DIP～機器組立)  
装置組立(各種産業機器・製造装置組立)



# マランツエレクトロニクス グループ

エレクトロニクス マニュファクチャリング サービス(EMS)

- MEK：基板設計～部品調達[集中購買]
- グループ工場：実装～ASSY・組立て



# 沿革

- 1972年10月 日本マランツ(株)の子会社として設立,音響機器の生産開始
- 1989年01月 音響から通信機へ生産アイテム変更
- 1989年03月 SMT実装機導入、チップ部品の実装開始
- 1996年02月 ISO9001認証取得 (TÜV)
- 1996年10月 半導体製造装置の組立開始
- 2002年 日本マランツ(株)より分社化したマランツエレクトロニクス(株)の子会社となる
- 2004年04月 ISO14001認証取得 (TÜV)
- 2010年12月 大型産業機器基板及びLED照明の生産開始
- 2017年01月 自動梱包機械の生産開始
- 2025年05月 X:640\*Y:610 超大型基板SMT実装ライン増設

# 企業理念と基本方針

## 企業理念

私達は、日本で電子機器の生産を行う顧客に、誠意と技術をもって応え、一人一人の成長と、会社の発展を目指す。

## 基本方針

品質、サービス、生産、物流、納期及びお客様対応等全ての面でお客様に喜んで頂けるように努める。

高い生産技術力を身に付け、我社でしかできないものづくりをする。

高付加価値の創出。

常に人の為に仕事をする。

いい仕事をして、仕事が集まる。

仕事と人が、共に成長する職場にする。

「継続は力なり」後戻りのない常に改善する会社にする。

常に自分に厳しく、向上心を持つ。

## 品質方針

顧客要求を第一に考え、顧客要求を満足する製品品質を確保するために、社員一人一人が自主的に必要な改善を行い、顧客満足度の向上を図る。

# 主要取引先

- オムロン阿蘇 株式会社
- 旭化成テクノシステム 株式会社
- 三菱電機エンジニアリング 株式会社
- 東洋電装 株式会社
- 株式会社 京製メック
- エスティケイテクノロジー 株式会社
- アドバンテック 株式会社
- 三和ニューテック 株式会社
- 株式会社 羽野製作所
- 櫻井精技 株式会社
- 株式会社 ホックス
- 熊本テクノ 株式会社
- テクノデザイン 株式会社
- 新電元テクノロジーサーチ 株式会社
- 株式会社 ジェーイーエル
- 明光電子 株式会社
- 千代田電子機器 株式会社
- マランツエレクトロニクス 株式会社

# 1. 基板実装事業（EMS製造部）

受託範囲：部品調達～SMT実装～後加工迄の一貫生産

主力アイテム：産業機器・パソコン・医療機器・自動車・LED照明・電車等

## SMT実装：生産

- プリント基板の高精度・高密度実装が可能な製造設備を有しており、試作・少量多品種案件から量産品まで幅広く対応致します
- 産業機器／バーインボード等の大型サイズの基板実装を得意としております (X:640\*Y:610\*t:8.0迄)
- 社内認定者による作業で高品質を確保  
(マシンオペレーター、目視検査、はんだ付け)
  - 機械実装可能スペック、部品サイズ
    - QFP(0.4mmピッチ)、BGA(0.4mmピッチ)
    - チップ実装(0402)、ボンド実装(1608)



▲0402対応SMT高速実装機

## SMT実装：生産

# 超大型基板の生産に特化したSMT実装ライン

【生産基板仕様】

サイズ：幅610×長さ640 ×厚さ8mm 重量：10kgまで対応

- ・半導体テスト用基板や大型特殊基板のSMT実装が可能です
- ・基板形状（角型・丸形）に合わせた搬送治具が作成可能です  
※基板搬送用と同時に基板反り矯正に役立っています



熟練技術者の確かな技術と、多様な先進設備によって、高い品質のサービスを提供できます

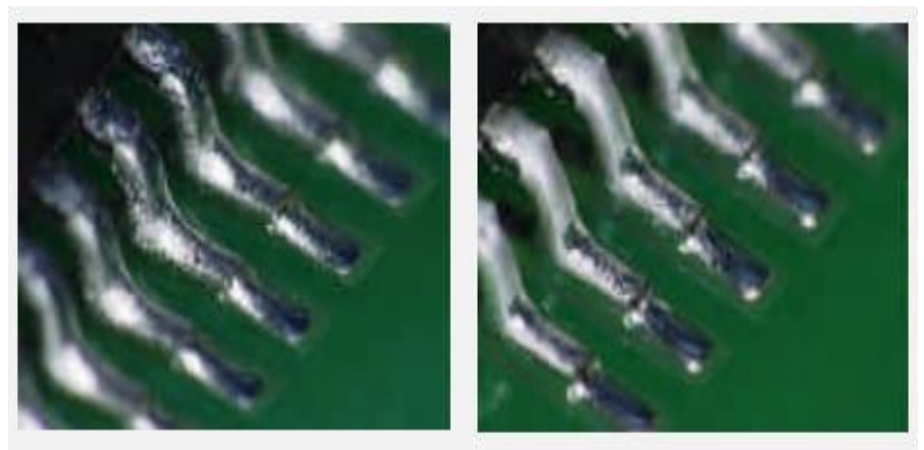
## SMT実装：生産

### N2 リフロー炉：SMT 実装ライン全てに対応

- 窒素雰囲気リフローによる高耐久性のはんだ付けが可能です
- 部品電極や基板ランドなどの酸化を抑制でき、高信頼性のはんだ付けが可能です
- はんだの濡れ性が向上し、フィレット形成が改善されます



▲千住金属工業製 SNR-1050GT



[N2リフロー]

[大気リフロー]

### CO2 レーザーマーカ（基板両面印字）

- 2次元コードを生基板に直接印字することで、製造工程情報及び部品ロットのトレースが可能です
- 2次元コード入りの基板は、各工程で製造情報(生産履歴、修理履歴、作業者情報等)が記録され、トレーサビリティ管理されます
- コードに紐づいた検査画像が残り、必要に応じて検索が可能です

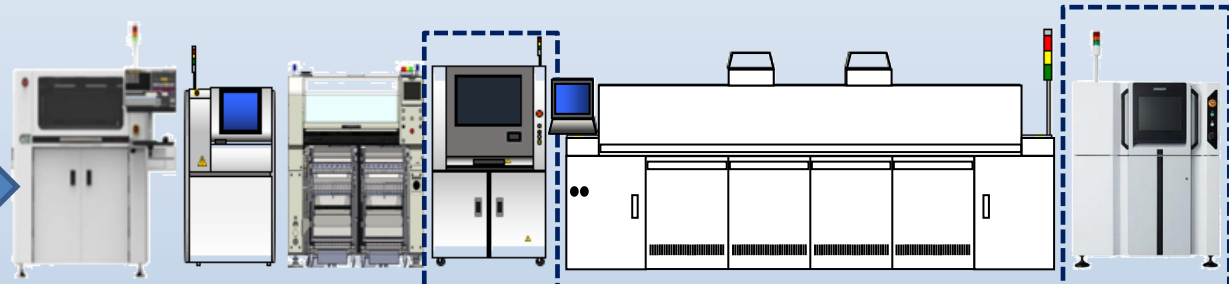
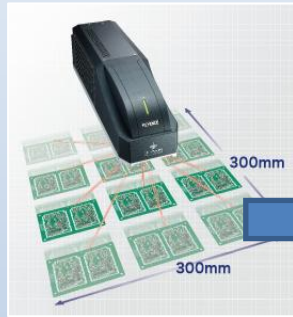


印字：バーコード・QRコード・英数文字・□等



▲小松電子製 LMK08X-K

# 生産プロセスと部品LOTのトレースシステム



	QR外形 3mm × 3mm (最小) 4mm × 4mm 5mm × 5mm (最大)
--	---

QRコードを基板に書き込んで  
SMTラインに投入

印刷検査機

IN-AOI

OUT-AOI

QRコード内格納データ	レーザー印字
KKM220012340001	0001
KKM220012340002	0002
...	...
KKM220012340100	0100

バーコード



↓ データ量の圧縮



二次元コード

西暦 + 日付 + 時間 +  
ロット + シリアルなど

従来は難しかった  
重複の無い採番も可能

- ◆ インライン・リフロー後履歴照合可能
- ◆ 検査データ画像保管



## SMT実装：品質

- リフロー前のインラインAOIによる迅速なフィードバックが可能です
- AOIの画像データは、長期保存/管理を実施しております  
(保存期間15年：シリアル・QRコード情報も保存可能)
- レーザーQRコード付与による基板トレース管理(基板1シート毎)  
や部品補充管理システムによる部品トレース管理が可能です
- 社内不良情報をデータベース化したシステムを構築しております



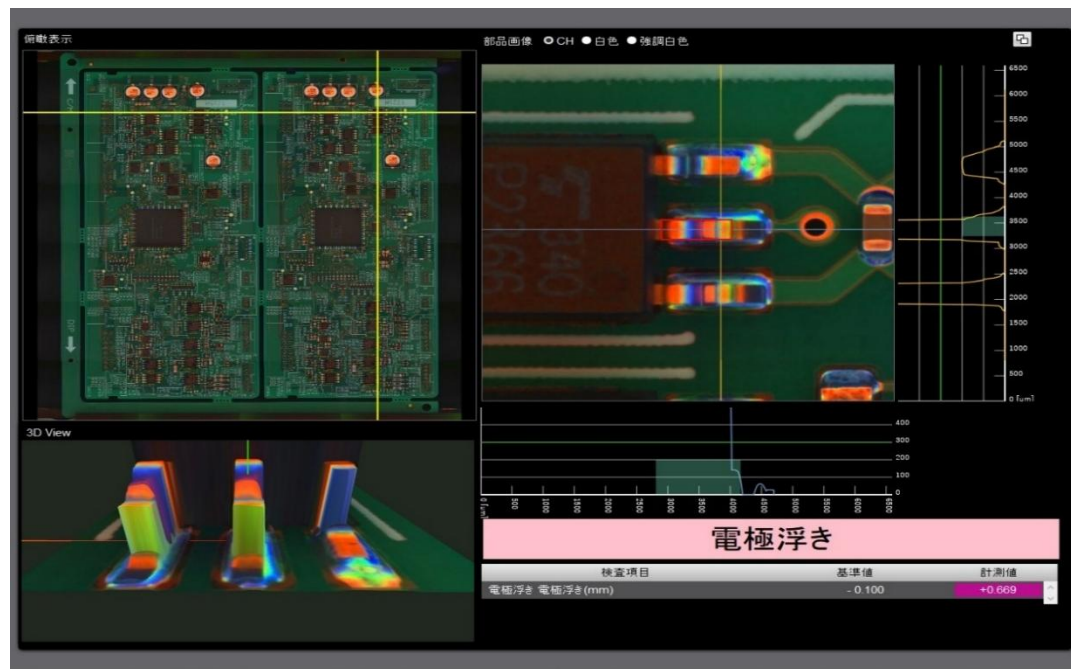
▲U22X-FMA650 (検査範囲 X:650 \* Y:550)  
マランツエレクトロニクス製 AOI



▲部品補充管理システム

## 3D-AOI（超大型基板サイズ対応）

- 検査精度向上により虚報(見過ぎ)が少なく、判定ミスリスクが改善
- 不良を捉えた際、「不良名」が画面に表示され判定しやすい
- 検査タクトが早く、検査処理能力が向上

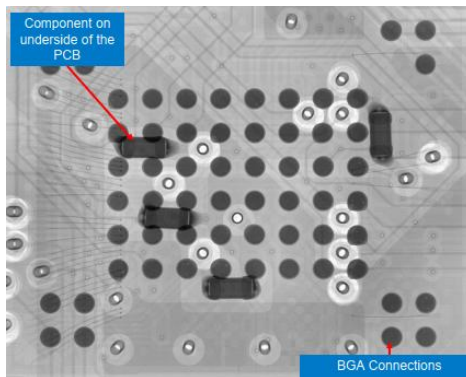


▲オムロン VT-S1080

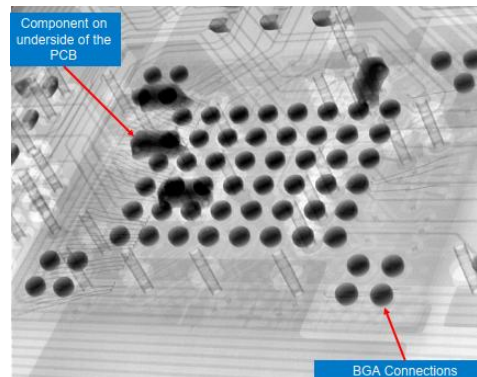
## 大型基板対応 X線画像検査装置

- XL型基板のX線画像検査が可能（最大検査範囲：510 × 444 mm）
- サンプルを中心に360°方向から多角度観察(2.5D)ができ、モニター観察や画像取得、動画撮影等が可能です
- 不良解析、不具合時のトレーサビリティ管理が可能です

高倍率、高解像度の画像や動画を  
安定的に取得可能



▲ 真上から撮影



▲ 斜め方向から撮影



## 後加工(フローはんだ～組立)

- 鉛フリー、共晶の自動はんだ付け装置(フロー槽 + 自動ポイントフロー槽)を保有しており、各基板仕様に応じたはんだ付けに対応しております
- 大型基板(X:610\*Y:460\*t:2.0)の鉛フリーフローはんだ付けが可能です
- 基板洗浄(一部外注含む)、防湿剤塗布(自動塗布・刷毛塗)に対応
- ICTのボードやフローパレット等、各種治具が製作可能です
- 各種 機器組立迄の一貫生産に対応しております



▲ L型基板対応 フロー槽[鉛フリー]



▲産業機器用 大型基板

## 後加工(防湿剤自動塗布)

### 自動塗布機によるワンランク上の高品質コーティング

- 専用機を使用した基板防湿処理(自動塗布)が可能です
- 溶剤の塗布ムラが無く、均一にコーティングが可能です
- 塗布後の個体差が少ない高品質を実現します

#### 【取り扱い溶剤】

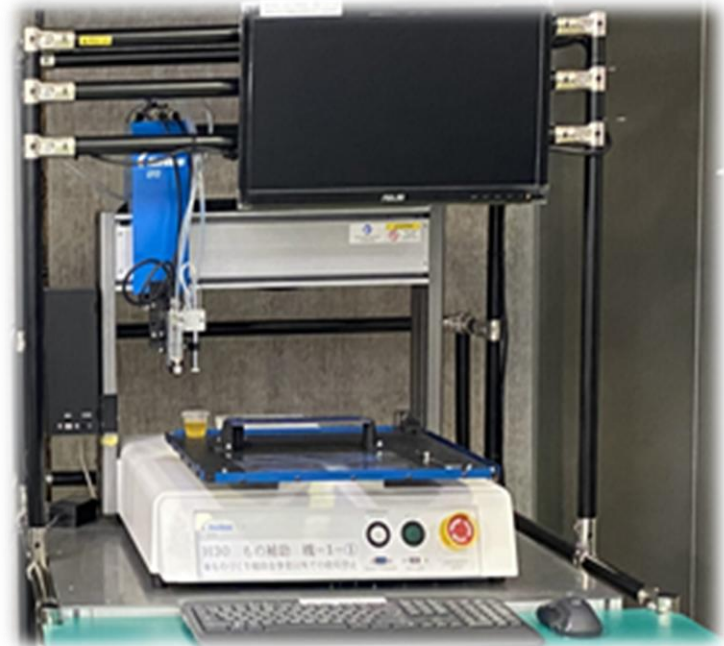
- 自動塗布機 -

ヒューミール 1A27NSLU

ヒューミール 1B51NSLU

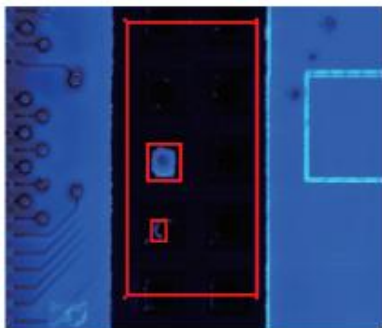
- 手塗り -

エレップコート LSS-520

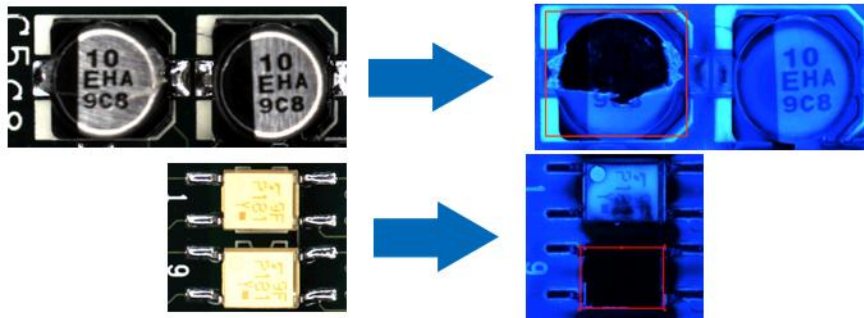


# 防湿剤塗布検査(UV-AOI)

- 基板防湿処理の塗布漏れや塗布禁止箇所の誤塗布を画像にて検出が可能です ※UV添加防湿剤の塗布



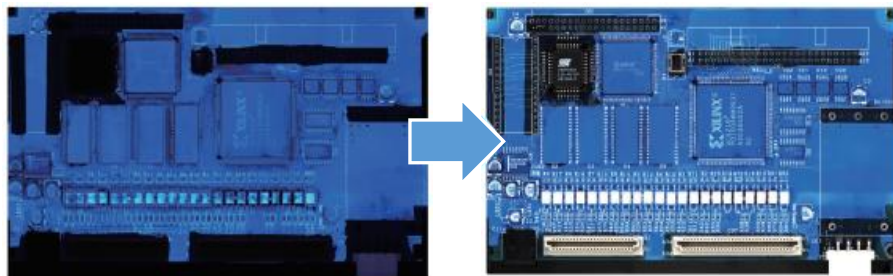
▲ 禁止エリアの溶剤飛散検出



▲ UVライトによる塗布漏れの検出

- 基板実装後の部品角度ズレ、搭載位置(極性・誤実装・文字・キズ・汚れ)の検出が可能です

塗布エリアの塗布有無箇所の識別が容易に目視可能



↑ UV照明のみ

↑ 白色照明 + UV照明



マランツエレクトロニクス製 UV-AOI

V22XUV-520

# X線チップカウンター

## 従来の手動リールカウンタの問題点をX線カウンタで解決

- チップ部品のカウント作業時間が大幅に短縮します
- 正確かつ短時間で棚卸しが可能です
- 作業者のスキルレス化(誰でも操作可能)

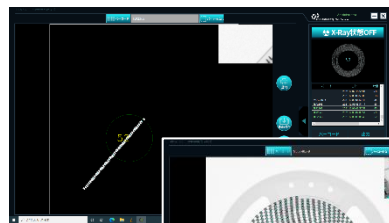


時従来時間の約1/4以下 ※自社調べ

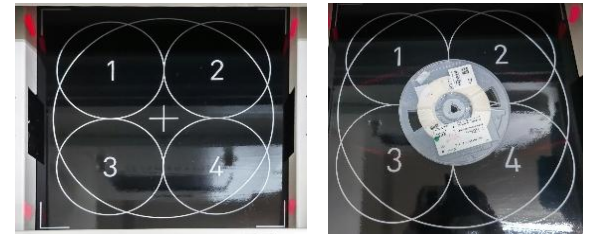
幅: 900mm  
奥行: 1640mm  
高さ: 1900mm  
現行モデル: HAWKEYE 2000 (KnK製)



▲従来は巻取りでカウントを行い、  
カウント後の巻き戻しが必要であった



←スティック品も  
そのまま投入OK



▲リールを置きスタートスイッチを押すだけの簡単操作  
※1回で、最大4リール同時カウント



← 部品のバーコードラベルを  
付属のハンディスキャナで  
読み込み



↑型式・カウント情報は  
ラベル印刷が可能

## リワーク装置

# 様々なSMTデバイスの取り外し、取付け、交換が可能



メイショウ製 MS900XL

- ・裏面電極部品の交換

BGA、LGA、QFNなどの裏面接合部品が搭載された基板のリワークが可能です

- ・各種パッケージのSMTデバイスに対応

上記のほか極小チップ、CSP、SON、QFP、コネクタなど

- ・各種基板仕様に対応

大型、多層、重量基板にも対応しております

- ・品質保証

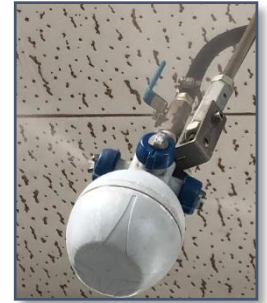
リワーク後は、顕微鏡検査及びX線画像検査装置による接合状態を確認し品質を保証しております

### 【マシンスペック】

基板対応サイズ：50×50～650×700(mm) 厚さ：最大10mm 重量：最大10kg

## 静電気を発生させない環境づくり

- ESD コーディネータ資格取得者による社内ESD環境の構築  
社内静電気管理基準を設け、帳票類で見える化し管理
- 作業区画には導電性マット敷き、  
静電気対策を施した自社製の台車・作業台を完備
- SMT実装フロアは、ミスト噴霧器による湿度コントロールで  
静電気発生を抑制
- はんだ印刷機前にイオナイザを配置



スプレーイングシステム  
(噴霧器)



イオナイザによる除電



ESD対策台車

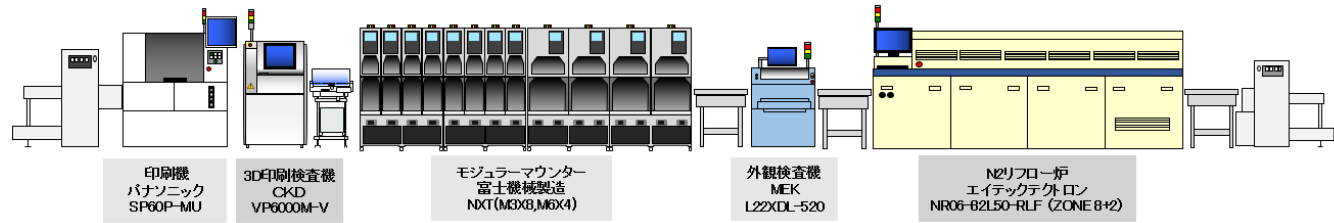


ESD対策作業台

# SMTライン設備構成

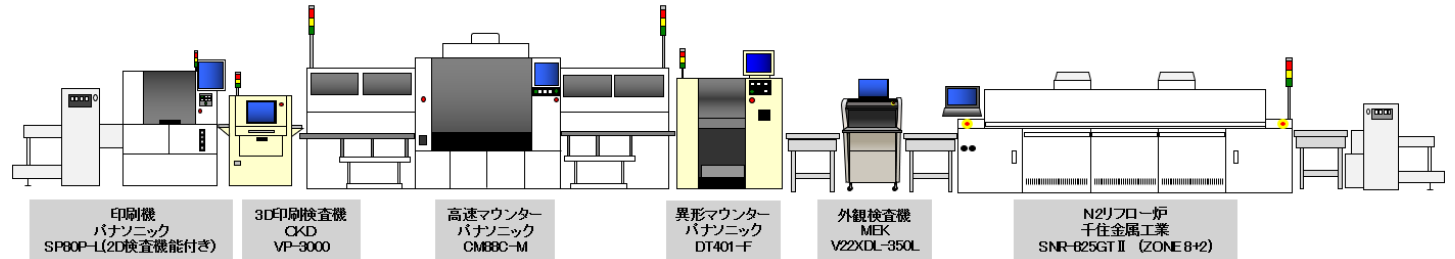
## 1号機

対応基板サイズ  
Min 100×80~Max 330×250  
対応基板厚 T0.6~3.0  
対応部品 0603~



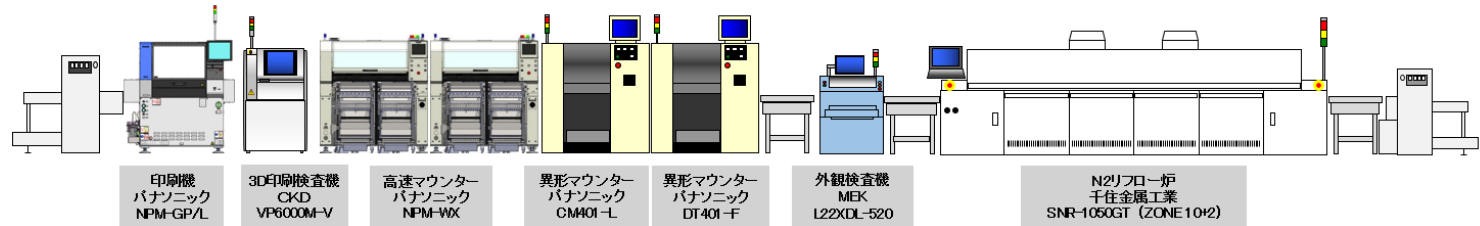
## 2号機

対応基板サイズ  
Min 80×50~Max 330×250  
対応基板厚 T0.6~3.0  
対応部品 1005~



## 3号機

対応基板サイズ  
Min 80×50~Max 330×250  
対応基板厚 T0.6~3.0  
対応部品 0402~



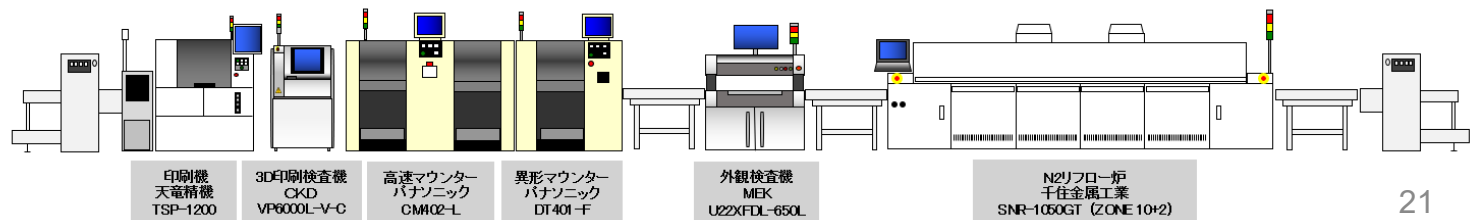
## 4号機

対応基板サイズ  
Min 85×80~Max 640×610  
対応基板厚 T0.6~8.0  
対応部品 0402~  
対応基板重量 10kg



## 5号機

対応基板サイズ  
Min 85×80~Max 640×460  
対応基板厚 T0.6~3.0  
対応部品 0603~



# 検査装置・リワーク装置・フロー設備

フィクチャレステスター

対応基板サイズ  
Min 50×50～  
Max 460×640  
基板厚 0.6～3.0t

タカヤ  
APT-7400CJ



リワーク装置

対応基板サイズ  
Min 50×50～  
Max 650×700  
基板厚 10.0t  
対応基板重量 10.0kg

メイショウ  
MS9000XL



アウトライン  
3D画像検査装置

対応基板サイズ  
Max 815×680mm  
基板厚 0.4～8.0t  
対応基板重量 12.0kg

OMRON  
VT-S1080L



アウトライン検査装置 (5台)

対応基板サイズ  
Min 50×50～Max 550×650  
対応基板厚 0.3～4.0t

外観検査機  
MEK  
L22XFMA-650



アウトライン検査装置(UV対応)

対応基板サイズ  
Min 50×50～Max 550×650  
対応基板厚 0.3～4.0t

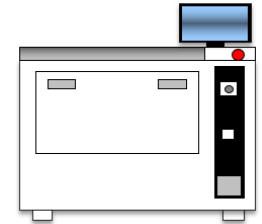
外観検査機(UV対応)  
MEK  
V22UVX-520



ポイントDIP装置  
セイテック N2

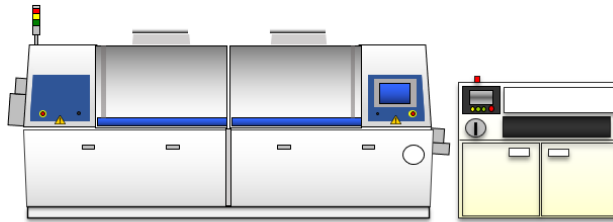
対応基板サイズ  
Min 50×50～  
Max 460×460

セレクトトレース  
はんだ付け装置  
セイテック (N2対応)  
STS-500Plus



DIP装置 (鉛フリー)  
千住金属工業 大気

対応基板サイズ  
Min 50×50～  
Max 460×610  
対応基板厚 0.6～2.0t



ポイントDIP装置  
弘輝テック  
ULTIMA-NEO-L Smart

対応基板サイズ  
Min 50×50～  
Max 380×460

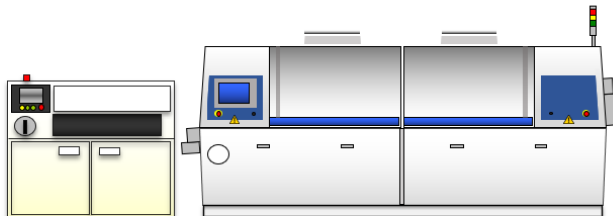
DIP槽  
千住金属工業  
SPF2-500

スプレーブクサー  
SSF2-400



DIP装置 (共晶)  
千住金属工業 大気

対応基板サイズ  
Min 50×100～  
Max 330×450  
対応基板厚 0.6～2.0t



スプレーブクサー  
TAF40-15PV

DIP槽  
千住金属工業  
SPF2-400

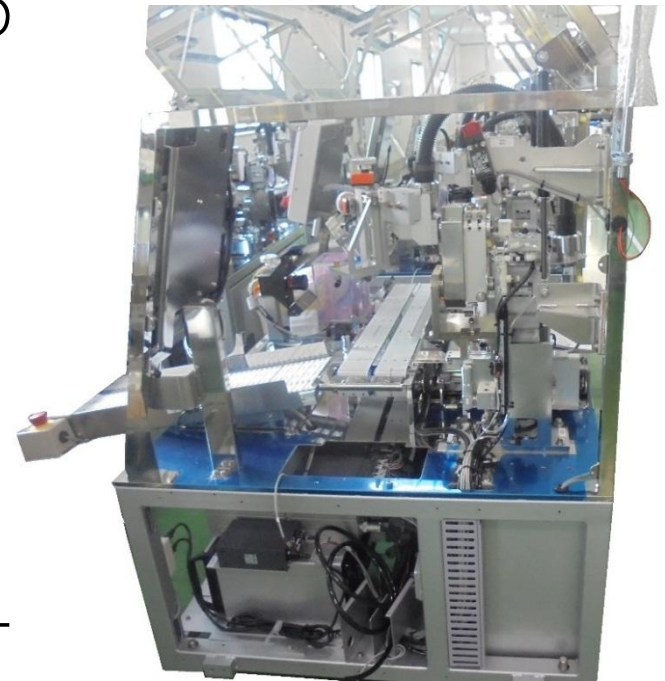
## 2. 装置組立事業（装置製造部）

受託範囲：ハーネス加工～制御ユニット及び本体組立・調整迄の一貫生産

主力アイテム：各種産業機器・検査装置・搬送装置等

### 装置組立：生産

- 各種ハーネス加工～制御ユニット組立迄の一貫生産で短納期対応が可能です
- メカユニットは、高精度の組立てを得意としております
- ハーネス・制御ユニット・メカユニット組立後装置本体搭載、最終調整・I Oチェックを経て出荷します
- 各種ユニットの単品組立から対応可能です



# (株)熊本マランツ レイアウト図

作成日：2025年 9月 5日 「31版」

